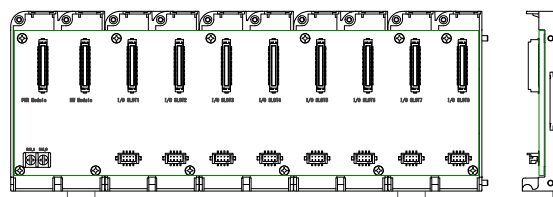


概要

本製品は、MRH-T シリーズの電源、通信、IO モジュールを実装するための専用ベースユニットです。
電源モジュールからの DC24V を一括で各モジュールに供給し、通信モジュールと IO モジュール間を内部通信バスで接続しています。



型式コード

MRH-T-BP10S1

型式

仕様

●基準性能

スロット数	10スロット 電源モジュール×1スロット 通信モジュール×1スロット IOモジュール×8スロット
RAS出力	Photo MOS リレー: a 接点 出力定格: 100V/350mA (ピーク AC, DC) 通信モジュール異常時: OPEN
絶縁抵抗	100MΩ以上 (DC500V): 内部回路— RAS出力—外部電源(※) 各間 ※外部電源 各間: 100MΩ以上 (DC500V)
耐電圧	AC1500V/1分間: 内部回路— RAS出力—外部電源(※) 各間 ※外部電源 各間: AC1500V/1分間
動作環境	温度: -5℃~55℃ 湿度: 5~90%RH (結露なきこと)
保存温度	-10~60℃

●取付・形状

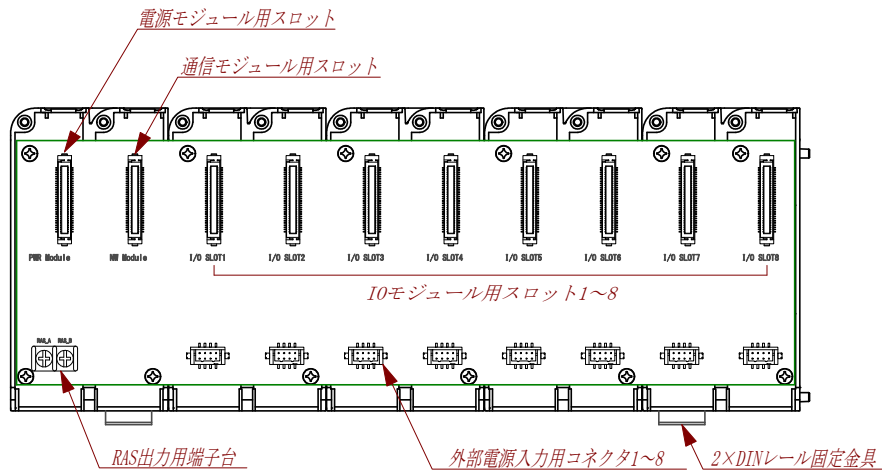
取付方法	DINレール取付
取付姿勢	垂直
配線方法	RAS出力端子台: M3 ネジ端子接続 外部電源入力用コネクタ: DF11CZ-8DP-2V (27) (HRS 社製)
ネジ締付トルク	0.65N・m±15%
適合圧着端子	R1.25-3 (JST、ニチブ社製) or 相当品
適合電線	0.3~0.75mm ²
外形寸法	W291×H115×D21mm (突起部含まず)
質量	322g typ.

●材質

本体ケース	ABS樹脂 (UL-94V-0)
端子台ネジ	鉄/ニッケルメッキ
基板	ガラスエポキシ (FR-4, UL94V-0)
防湿処理	ヒューミシールコーティング: HumiSeal 1A27NSLU (ポリウレタン樹脂)

実装位置図

電源モジュールは、左端のスロット（シルク印字：PWR Module）に実装してください。
 通信モジュールは、左から2番目のスロット（シルク印字：NW Module）に実装してください。
 IOモジュールは、左から3番目のスロット～右端のスロット（シルク印字：I/O SLOT1～I/O SLOT8）に実装して下さい。
 電源モジュール用スロットの下側に RAS 出力用端子台、IOモジュール用スロットの下側に各 IOモジュールの外部電源入力用コネクタを実装しています。



外形寸法

